

# 技術資料

## EP-3000 絕緣接著劑

### 產品說明：

**EP-3000** 為單液型環氧樹脂絕緣接著劑，適用於一般小型半導體晶片，並可以自動機台黏著固定使用，對大多數材質皆有良好接著性。

### 產品特徵：

- 降低樹脂溢流及揮發的可能性。
- 中等黏度範圍可適用於沾膠或背膠之製程。

硬化前特性	測試條件	測試方法
比重 1.0~1.4 g/cc	比重計	FT-P001
外觀 白色		
黏度 @ 25°C 24000~28000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C 1.0~1.4	Brookfield DV-III/CP-51 黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	FT-P008
細度 < 10 μm	細度計	FT-P026
水含量 < 0.7 %	水份計	FT-P002
使用壽命 @ 25°C 24 hours	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P024
保存期限 @ -40°C 6 months		FT-P018
烘烤條件	測試條件	測試方法
標準烘烤條件	60 分鐘 @150°C (烘箱烘烤)	
物理及化學性質	測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg) 127°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數 <Tg 49ppm/°C >Tg 190 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
機械性質	測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C >350 g/die	晶片尺寸 10mil × 10mil (銀支架)	FT-M012

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。